

시스텍과 토판, 전 세계에 브랜드 보호 솔루션을 제공하기 위한 파트너십 체결

프린스턴, 뉴저지주 -- 최고의 공급체인 보안과 브랜드 보호 서비스를 제공하는 글로벌 유수의 기업 시스텍(Systech)과 제품 패키징과 보안 솔루션 업계 혁신기업이자 프린팅 업계를 이끌어 가는 세계적인 기업 토판 프린팅(Toppan Printing 또는 토판)이 파트너십을 체결했다는 소식이다. 양사는 시스텍의 전자지문(e-Fingerprint®) 디지털 기술을 토판의 프린팅 솔루션 서비스에 통합한다는 내용의 5년간 유효한 글로벌 라이선싱 계약을 체결했다.

"시스텍의 전자지문 기술을 토판의 우수하고 탄탄한 솔루션들에 내장하면, 글로벌 규모의 대량 지능형 패키징을 실현할 수 있게된다"고 시스텍의 CEO인 아라 오하니안(Ara Ohanian)은 전했다.

이번 협력으로 시스텍과 토판은, 위조를 방지하고 글로벌 차원의 제품의 유출을 예방하는 혁신적인 브랜드 보호 솔루션들을 제공할 수 있다. 또한 양사 서비스들의 결합으로, 각 브랜드들은 공급망 절도로 인한 브랜드 매출 악화를 방지할 수 있으며 가장 중요한 것은 잠재적 유해성을 가진 제품들로부터 고객들을 보호할 수 있다.

"시스텍과 파트너십을 강화하게 되어 매우 자랑스럽다. 시스텍의 독창적이며 비부착식(non-additive)의 입증된 브랜드 안전 솔루션은, 기존 제품의 바코드와 패키징을 활용해 복제할 수 없는 고유한 서명을 만든다. 양사의 전문성이 결합되 브랜드 자산과 소비자 안전을 보호하고 지킬 수 있다"고 토판의 플랫폼 비즈니스 센터 총괄(Head)인 타케시 카바야마(Takeshi Kabayama)는 전했다.

주요 제조 브랜드들은 점점 증가하고 있는 제품 위조와 유출 문제를 해결하기 위해 기존의 기술들을 빠르게 채택하고 있다. 하지만 해당 패키징 요소들의 대다수는 부착식이며 많은 비용을 요구한다. 현재, 글로벌 공급망 침입은 점차 증가하고 있으며 복제가 가능한 낡은 기술들로 제품들을 추적하는 것은 점점 더 어려워 지고 있다.

기업들이 부착식 위조방지 패키징에 매년 1천5백달러(USD) 이상을 지출하고 있으며 이것은 놀라울 만큼 큰 금액이다. 홀로그램, 특수 실이나 잉크, 워트마크, RFID 태그에 이르기까지 현재 활용되고 있는 모든 것들은 생산라인 상의 변화와 추가 비용을 요구한다는 한계가 있다. 시스텍의 기술은 비부착식의 비용 효율적인 기술로 기존의 제품과 라벨링 생산 라인들에서 손쉽게 구현된다.

시스텍(Systech)

시스텍은 브랜드 보호에 혁신의 바람을 불러일으키고 있다. 30년 이상 글로벌 브랜드들은 위조방지, 제품유출 방지, 규정준수를 위해 시스텍의 첨단 소프트웨어에 의존해 왔다. 첨단 머신비전 기술 스타트업에서부터 약품 일련번호의 선구자적인 개척 그리고 혁신적인 추적식과 비부착식 인증에 이르기까지, 시스텍의 DNA에는 혁신 그 자체가 뿌리깊이 새겨져 있다. 시스텍의 소프트웨어 솔루션들은

제품이 제조에서부터 고객들에게 전달되기 까지 공급망 전반에 걸쳐 제품을 확실하고 안전하게 인증하고 보호하며 연결한다.

토판(Toppan)

토판은 인쇄, 통신, 보안, 포장, 장식재료 및 전자 분야 통합 솔루션을 제공하며 업계 선두를 달리는 글로벌 유수의 기업이다. 5만명 이상의 직원들로 구성된 토판의 글로벌 팀들은 모든 비즈니스와 산업 전반에 걸친 광범위한 서비스를 제공하며, 급변하는 오늘날의 시장에서 기업과 사회가 직면한 다양한 도전과제들을 해결하기 위해 업계 최고의 전문성과 기술을 통해 최적의 솔루션을 제공한다. 관련 보다 상세한 정보는 토판의 웹사이트(www.toppan.com/en)를 방문하거나

링크드인(<https://www.linkedin.com/company/toppan-printing/>)을 팔로우하면 확인할 수 있다.

미디어 문의:

제퍼슨 바(Jefferson Barr), VP 마케팅, 시스텍

Jefferson.barr@systechone.com

PR, 토판 프린팅(Toppan Printing)

kouhou@toppan.co.jp